



关于广东嘉元科技股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的
审核中心意见落实函之回复报告

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

上海证券交易所：

贵所于 2022 年 5 月 13 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕93 号《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称“落实函”）已收悉，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为本次广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“发行人”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，与广东嘉元科技股份有限公司、广东信达律师事务所（以下简称“发行人律师”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人申报会计师”、“会计师”）对落实函所列问题认真进行了逐项落实，现对落实函问题回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的相同。

问题一、请发行人进一步披露：今年上半年疫情对公司业务经营的影响，并揭示相关风险。

一、今年上半年疫情对公司业务经营的影响及风险提示

今年上半年，新冠疫情在国内局部地区反复。从下游市场发展趋势、向上游采购情况以及公司自身生产经营等角度分析，本次疫情并未对公司业务经营带来重大不利影响，具体情况如下：

从下游市场需求角度，公司下游主要应用领域的新能源汽车市场呈现较为景气的增长趋势，根据中汽协数据，2022年1-4月，国内新能源汽车产销量分别达到160.5万辆和155.6万辆，同比增长113.7%和112.2%，下游行业的发展持续带动公司产品市场需求的提升。

在公司向上游采购的角度，以公司主要原材料铜线为例，公司与主要供应商长期合作，在保证原材料质量的前提下，尝试开拓新的供应商，争取获得更好商务条件的同时增加了采购来源的多样性，尽可能降低局部地区疫情突发可能带来的原材料短缺风险。

公司在充分保障防疫安全的前提下有序开展生产经营活动，2022年1-3月产能利用率超过100%。根据公司未经审计的财务报表，2022年1-3月，公司包括营业收入、营业利润、归属于母公司股东的净利润等在内主要经营指标较上年同期均实现增长。其中，营业收入为96,268.65万元，较去年同期增长81.44%；营业利润为20,559.69万元，较去年同期增长57.72%；归母净利润为17,402.20万元，较去年同期增长57.29%。公司克服疫情等不利因素，实现了经营业绩的增长，体现出稳健的持续经营能力。

综上，今年上半年疫情对公司业务经营的影响较为有限，不存在影响持续经营能力的情形。

二、核查程序及核查结论

（一）核查程序

1、查阅行业数据、研究报告等，了解发行人产品下游应用市场的情况，确认公司产品主要应用的新能源汽车市场的需求变化趋势；

2、获取采购台账，访谈发行人采购人员，了解公司向上游采购主要原材料的情况；

3、查阅公司 2022 年一季度未经审计或审阅的财务报表，了解公司业绩及同比变动情况。

（二）核查结论

截至本回复出具日，今年上半年疫情对公司业务经营的影响较为有限，不存在影响持续经营能力的情形。

问题二、请发行人进一步说明：（1）PCB 铜箔产品的在手订单和客户情况，补充客户的稳定性、融资规模的合理性；（2）结合在手订单及发行人与宁德时代的合作协议、产能选址情况与下游需求的匹配度，补充大规模融资扩产的必要性；（3）2022 年第一季度业务经营情况，并按照相关规定提交更新数据后的申报文件。

一、PCB 铜箔产品的在手订单和客户情况，补充客户的稳定性、融资规模的合理性

（一）PCB 铜箔产品的在手订单与客户情况、客户的稳定性

发行人于 2001 年成立以来一直从事各类铜箔的研发、生产及销售工作。在 2015 年及之前，发行人主要研发、生产和销售厚度在 $8\mu\text{m}$ 及以上的锂电铜箔、 $12\mu\text{m}$ 及以上 PCB 用标准铜箔。2016 年之后，发行人成功突破了 $6\mu\text{m}$ 及以下铜箔生产技术，并随着发行人对 $6\mu\text{m}$ 及以下铜箔制造工艺的不断优化和改良，发行人逐步转向生产极薄锂电池用铜箔产品为主。但发行人也一直延续了原有 PCB 铜箔产品生产，并持续维持与老客户如骏亚电子、金安国纪、博敏电子、深圳金

诚盛、龙宇电子等公司的良好合作关系。发行人与骏亚电子、金安国纪、博敏电子、深圳金诚盛、龙宇电子等公司合作时间最少在3年以上，最长的超过10年，具备良好的稳定性。

2022年1-4月，公司的PCB铜箔产品销售收入为4,414.15万元(未经审计)。截至2022年4月末，公司PCB铜箔产品在手订单金额合计为837.51万元，在手订单数量相对有限。主要原因系：①发行人目前PCB铜箔产能有限。2021年公司PCB铜箔产能0.2万吨，但全年产量0.31万吨、销量0.30万吨，该类产品的全年产销量远高于公司产能；可见，虽然客户对发行人PCB铜箔产品的需求强烈，但受限于现有产能规模，公司难以响应更多PCB客户的需求。受前述原因影响，导致发行人当期在手订单数量有限。②发行人PCB铜箔产品从客户下单到企业生产、再到最终交付给客户，中间的周期较短（一般约为1-2周）；因为铜箔价格与上游铜材料的价格波动息息相关，涉及铜价等原材料价格波动，发行人的客户通常不会一次性购买较多的订单，而是通常根据自身需求按批次、日、周或月等周期进行采购，所以发行人在手订单数量有限。

（二）未来拟拓展的客户情况

公司目前PCB业务重点开拓、拓展的客户如下表所示：

客户全称	客户未来预计的采购需求	目前所处的合作阶段
广东生益科技股份有限公司 (SH: 600183)	6000-7000 吨/年	产品测试阶段
金安国纪科技股份有限公司 (SZ: 002636)	5000-6000 吨/年	小批量合作
其他现有客户	2000-3000 吨/年	小批量合作
正在开拓的客户群体	4000 吨/年以上	产品送样或测试阶段

注：该等客户采购需求以公司最终向客户的销售量为准。

发行人目前重点开拓的客户有广东生益科技股份有限公司（SH：600183，以下简称“生益科技”）。拟在现有合作的基础上大力扩展规模的客户有金安国纪科技股份有限公司及其子公司（SZ：002636，以下简称“金安国纪”）、博敏电子股份有限公司及其子公司（SH：603936，以下简称“博敏电子”）、广东骏亚电子科技股份有限公司及其子公司（SH：603386，以下简称“骏亚电子”）等客

户。

公司与生益科技的合作目前已经到了产品测试阶段，与金安国纪、博敏电子、骏亚电子目前已有合作。因锂电下游市场需求旺盛，发行人根据实际情况调整排产计划，目前主要产能用于生产锂电铜箔，仅少量产能用于生产 PCB 铜箔，故暂时未能提高 PCB 铜箔产销量。后续拓展重点在增加相关客户对发行人 PCB 铜箔产品的采购量，在未来产能释放后，发行人 PCB 铜箔的产销量将得到提升。

除上述重点客户之外，发行人还将凭借自身的在极薄铜箔、高端 PCB 铜箔领域的技术实力、销售能力、以及多年来在铜箔行业所积累的客户资源，拓展其他新增客户资源。

（三）PCB 市场发展概况

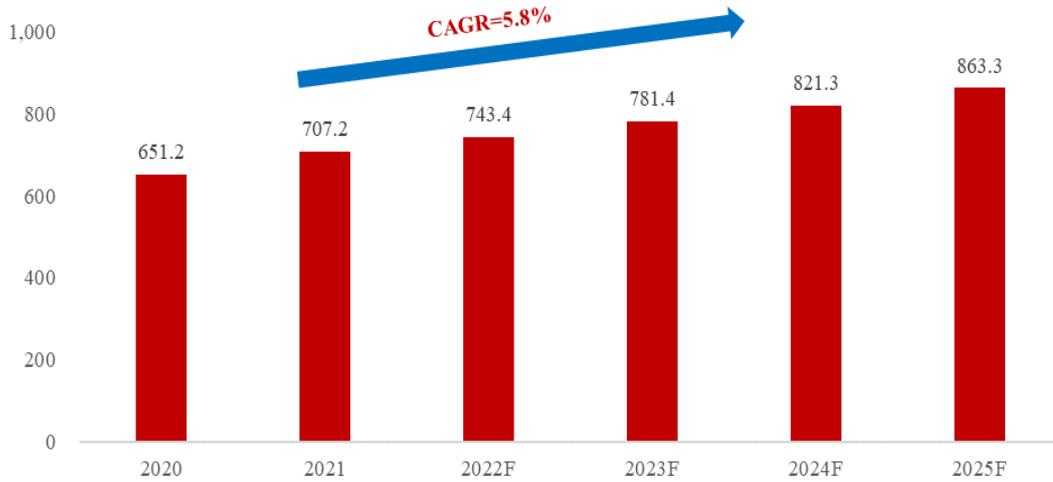
1、目前市场发展情况

PCB 铜箔是覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）制造的重要原材料，起到导电体的作用。

CCL 与 PCB 被普遍应用于电子信息产业。CCL 是 PCB 的重要基础材料，而 PCB 是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，被广泛应用于通讯设备、汽车电子、消费电子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。

经过几十年的发展，PCB 行业已成为全球性规模较大的行业。近年来，全球 PCB 产业产值占电子元件产业总产值的 25%以上，是电子元件细分产业中比重最大的产业。根据 Prismark 的数据，在全球电子信息产业持续发展的带动下，2020-2025 年全球 PCB 行业将以 5.8%的年复合增长率增长，2025 年全球 PCB 行业市场规模将达到 863.3 亿美元。受益于直接需求的下游 PCB 行业的稳定增长，PCB 铜箔行业增长亦具备持续性和稳定性。

2020-2025 年全球 PCB 行业市场规模及预测（单位：亿美元）



数据来源：Prismark

全球 PCB 产业链最早由欧美主导，随着日本 PCB 产业的兴起，逐渐形成美欧日共同主导的格局。进入二十一世纪以来，受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球 PCB 产业重心亦逐渐向亚洲转移。中国 PCB 制造产业在近年来飞速发展，根据 Prismak 发布的 2021 年度全球前 50 强 PCB 供应商榜单，中国大陆共有 10 家企业上榜，其中包括东山精密、深南电路、胜宏科技、奥士康等。中国台湾地区有 14 家企业上榜，其中多家企业在中国大陆建立有大型生产基地。此外，PCB 下游应用各细分领域，中国大陆地区也有诸多龙头企业，包括华为、联想、均胜电子、汇川技术等。因此，我国 PCB 铜箔需求量非常旺盛。

电子信息产品不断发展升级，在对 CCL 及 PCB 提出更低成本、更高质量要求的同时，也对铜箔的低成本、高性能、高品质及高可靠性等方面提出更严格的要求。作为 PCB 不可缺少的主要原材料，PCB 铜箔一直随 PCB 技术的发展而得到广泛应用，譬如大功率 PCB 在高档汽车安全性、稳定性方面体现出其独特性能和优势，应用于大功率 PCB 的高档 PCB 铜箔也受到汽车行业的高度关注。随着信息传递向数字化和网络化方向发展，PCB 工业亦持续快速进步，同时推动着 PCB 铜箔行业快速向前发展。

预计未来数年，中国 PCB 铜箔市场的增长驱动力主要包括：

(1) 5G 基站/IDC 建设带动高频高速电路铜箔发展，5G 网络驱动消费电子产品用标准铜箔需求增长；

(2) 充电桩及新能源汽车市场发展，带动大功率超厚铜箔需求增长；

(3) 更多高性能铜箔国产化替代。

2、政策情况

近年来，国务院及有关政府部门颁布了一系列政策，促进了 PCB 铜箔行业的发展，其中对行业影响较大的法律法规和产业政策包括：

序号	发布时间	产业政策	颁布/编制单位	相关产业政策内容
1	2016 年 9 月	鼓励进口技术和产品目录（2016 年版）	国家 发 改 委、财政部、商务部	将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制”列入“鼓励发展重点行业”
2	2017 年 1 月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）	国家发改委	在“新一代信息技术产业”之条目“2.2.3 新型元器件”中包含了高密度互连印制电路板（包括刚性、挠性、刚-挠性印制电路板、印制电子、埋置元件电路板及光电印制板）、柔性多层印制电路板、特种印制电路板（包括高多层背板、LED 用印制电路板）
3	2018 年 11 月	《战略性新兴产业分类(2018)》	国家统计局	将 PCB 用高纯铜箔列入“3.2.2.3 高品质铜材制造”，高纯铜箔系国家战略新兴产业
4	2019 年 11 月	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发改委	将“高密度印刷电路板、柔性电路板、高频微波印制电路板、高速通信电路板”和“高性能铜箔材料”纳入国家重点鼓励项目
5	2020 年 12 月	《鼓励外商投资产业目录》（2020 年版）	国家发改委	将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板”列入鼓励外商投资产业目录

3、现有产能情况、可比公司扩产情况

发行人 PCB 铜箔现有产能为 0.20 万吨/年，根据 GGII 的研究报告，2021 年 PCB 铜箔市场需求为 54.87 万吨，发行人现有产能仅占全市场需求量的 0.36%。预计募投项目 2025 年达产后发行人 PCB 铜箔产品规划产能可占全市场需求量的 3.01%，市场占比同样较低。

单位：万吨

项目	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
现有产能①	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
前次募投项目达产后预计新增产能②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本次募投项目达产后预计新增产能③	0.00	0.00	0.80	1.60	2.00
全部规划产能（④=①+②+③）	0.20	0.20	1.00	1.80	2.20
市场需求（⑤源于 GGII 出具的研究报告）	54.87	58.93	63.29	67.97	73.00
占比（④÷⑤）	0.36%	0.34%	1.58%	2.65%	3.01%

近年来，行业内知名公司多在布局产能扩张。根据公开信息整理，部分可比公司 PCB 铜箔的产能扩张情况如下：

序号	公司名称	扩产事项
1	诺德股份	2022 年 1 月公告拟投资建设诺德 10 万吨铜箔材料新生产基地，一期项目拟建设 5 万吨高端锂电铜箔及 5G 高频高速电路板用标准铜箔，预计 2023 年 6 月前投产
2	灵宝华鑫	2020 年至 2024 年计划会同旗下子公司通过新建、扩建、收购资质优良的铜箔企业，预期产能将达 10 万吨/年
3	超华科技	2021 年 2 月公告拟投资建设年产 10 万吨高精度电子铜箔产业基地，其中一期项目年产 5 万吨，总建设期三年，固定资产投资概算 40.2 亿元
4	铜冠铜箔	2022 年 1 月首次公开发行上市，拟投资 8.21 亿元用于新增年产 1 万吨高精度电子铜箔产能，项目建设期为 21 个月
5	德福科技	2021 年 12 月申报首次公开发行上市，拟投资 13.03 亿元用于新增年产 2.8 万吨电解铜箔生产线，产线定位为高档锂电铜箔及电子电路铜箔

综上所述，行业内头部企业均在布局高端、高精度 PCB 铜箔的产能。

4、下游公司扩产情况

发行人“江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目”主要产品为满足高密互连多层 HDI 电路板和 5G 高频高速电路板用高端电解铜箔。为满足不断扩大的市场需求、顺应 PCB 产业链向国内转移的行业发展趋势，国内 PCB 企业正在积极扩产。部分知名企业披露的扩产情况如下：

序号	公司名称	扩产事项
1	景旺电子	拟投资 18.19 亿元用于珠海景旺（一期）年产 120 万平方米多层印刷电路板项目，设计年产能 120 万平方米多层 RPCB，计划于 2023 年 3 月完工； 拟投资 26.89 亿元用于珠海景旺高密度互连印刷电路板项目，设计年产能 60 万平方米 HDI，计划于 2024 年完工

序号	公司名称	扩产事项
2	兴森科技	2021年3月披露拟投资15.80亿元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目，设计年产能96万平方米印刷线路板
3	崇达技术	2022年1月披露拟投资36.51亿元用于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期），设计年产能108万平方米高多层板和42万平方米HDI板，项目建设期为24个月
4	胜宏科技	拟投资29.89亿元用于高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目，设计年产能145万平方米高端多层板、40万平方米高阶HDI板和14万平方米IC封装基板，项目建设期为24个月
5	明阳电路	投资1.59亿元用于九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目，预计投产时间为2022年6月
6	生益电子	投资20亿元用于东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目，设计年产能35万平方米，预计将于2022年四季度试生产；拟投资13亿元用于吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目，设计年产能54万平方米，预计将于2023年四季度试生产

（四）发行人产品的竞争优势

发行人PCB铜箔产品与可比公司PCB铜箔产品的部分参数对比如下表所示：

产品特征	发行人			诺德股份	超华科技			铜冠铜箔
	VLP12 μ m	VLP18 μ m	RTF12 μ m		VLP12 μ m	RTF15 μ m 1型	RTF15 μ m 2型	
厚度				—				
基重 (g/m ²)	105 \pm 3	153 \pm 5	103 \pm 2.5	—	102	131	131	153 \pm 5
铜纯度 (%)	\geq 99.8	\geq 99.8	\geq 99.8	—	—	—	—	\geq 99.8
抗拉强度 (MPa)	23 $^{\circ}$ C \geq 300	\geq 300	\geq 350	—	\geq 280	\geq 350	\geq 350	\geq 280
延伸率 (%)	23 $^{\circ}$ C \geq 6.0	\geq 7.0	\geq 5.0	—	\geq 5.0	\geq 5.0	\geq 5.0	\geq 4
粗糙度 (μ m)	Ra	\leq 0.40	\leq 0.40	<0.6	—	—	0.3-0.6	0.2-0.5
	Rz	\leq 2.5	\leq 2.5	<3.0	—	\leq 3.0	3.0-4.5	2.0-3.0
抗高温氧化性	不变色	不变色	不变色	—	—	无异常	无异常	不变色

注1：部分可比公司未披露相关数据，以“—”列示。

注2：上述数据来源为可比公司官方网站。

如上表所示，发行人可比公司诺德股份未披露其生产PCB用高性能电子电路铜箔的具体参数。相较于其他可比公司产品，发行人产品在抗拉强度、延伸率、粗糙度等方面具有一定优势。上述产品优势可以帮助发行人实现对下游客户的拓展。

（五）融资规模的合理性

综上所述，在 PCB 产业蓬勃发展的背景下，目前国内知名 PCB 公司多在规划产能扩张，未来高端 PCB 铜箔的市场需求有充分保障。而高端高性能 PBC 铜箔国产化进程替代已经开启，同行业龙头企业已在布局 PCB 铜箔的扩产计划，以抢占市场先机。

发行人现有 PCB 铜箔产能小、市场占有率低，以 GGII 披露的研究数据估算，发行人 PCB 铜箔产能仅占市场需求比例的 0.36%。因此，发行人新增投产年产 2 万吨电解铜箔项目，以满足高密互连多层 HDI 电路板和 5G 高频高速电路板用高端电解铜箔及其他 PCB 铜箔的市场需求。该项目完全达产后，发行人在 PCB 铜箔市场的占有率仍然偏低，该等产能扩张具备可实现性。

此外，发行人自 2001 年成立以来一直从事各类铜箔的研发、生产及销售工作。在 2015 年及之前，发行人主要研发、生产和销售厚度在 8 μm 及以上的锂电铜箔、12 μm 及以上 PCB 用标准铜箔，在 2016 年起主要生产 6 μm 及以下铜箔之后，也保持了原有 PCB 铜箔产品生产，并持续维持与老客户如骏亚电子、金安国纪、博敏电子、深圳金诚盛、龙宇电子等公司的良好合作关系。发行人与骏亚电子、金安国纪、博敏电子、深圳金诚盛、龙宇电子等公司合作时间最少在 3 年以上，最长的超过 10 年，具备良好的稳定性。此外，发行人也正在拓展与广东生益科技股份有限公司的合作，目前正处于样品测试阶段，未来有较大可能性达成最终合作。根据对下游客户的访谈，生益科技预计未来对公司的采购量可达到 6,000-7,000 吨/年，金安国纪预计未来对公司的采购量可达到 5,000-6,000 吨/年。

故综上所述，发行人 PCB 铜箔产品面临较广阔的下游市场空间，同时发行人在相关行业具备多年的积累，具备客户资源与技术实力，未来产能消化有保证，融资规模合理。

二、结合在手订单及发行人与宁德时代的合作协议、产能选址情况与下游需求的匹配度，补充大规模融资扩产的必要性

（一）在手订单情况

公司与下游客户一般采用“铜价+加工费”的定价机制。由于大宗商品铜价的波动性较强，为了规避铜价波动对交易价格的影响，客户一般采用按需采购的方式进行交易，公司也尽量避免与客户签订长期大额销售合同。截至 2022 年 3 月末，公司在手订单销售总额约为 3.3 亿元，占公司 2021 年全年营业收入的比例约为 11.77%，占公司 2022 年第一季度营业收入的比例约为 34.28%。故公司在手订单并不能全面反映公司所面临的下游需求情况。

（二）发行人与宁德时代的合作情况

公司已与宁德时代建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商，公司 2018-2020 年连续被宁德时代授予“宁德时代锂电铜箔优秀供应商”称号。2021 年公司获得宁德时代“十年贡献奖”。

根据宁德时代公开披露的资料，2021 年全年宁德时代的电池产能为 170.39Gwh，在建产能 140Gwh，规划 2025 年之前实现产能 670GWh 以上，年复合增长率超达到 40%。嘉元科技 2021 年全年锂电产能 2.4 万吨，预计相关项目投产后 2025 年产能达到 8.70 万吨。复合增长率达到 38%。嘉元科技的锂电铜箔产能的增速与宁德时代自身产品的产能增速相匹配。

发行人于 2020 年 11 月与宁德时代签订了有效期为三年的《框架采购合同》，该合同对双方的合作的基本内容进行了约定，发行人目前与宁德时代的合作正常开展，预计后续随着宁德时代及发行人新产能的不断投产，双方的合作过程将持续深化。

（三）产能选址情况与下游需求的匹配度

发行人目前产能选址主要分布于广东梅州、福建宁德、江西赣州、山东聊城等地点。

1、广东梅州

公司自 2001 年在广东省梅州市梅县区雁洋镇设立以来,经过 20 余年的发展
与沉淀,极薄铜箔生产技术达到行业领先水平,多项技术填补了国内空白;并在
梅州本地先后组建了广东省企业重点实验室、广东省工程技术研究开发中心、广
东省企业技术中心等研发平台,与部分高校形成了良好的产学研合作关系。

根据《梅州市铜箔—高端印制电路板产业集群发展规划(2021—2025 年)》,
梅州目前已经建成了初具规模、行业骨干企业集聚、细分领域优势初现的铜箔—
高端印制电路板产业集群。早在 1985 年,梅州首家线路板厂广通线路板厂(国
营企业)正式投产,1993 年五洲电路板有限公司成为我市第一家民营电路板厂;
上世纪 90 年代广东超华科技股份有限公司引进第一条年产 600 吨的电解铜箔生
产线,梅州就开始了铜箔产业发展之路。2000 年以后,包括发行人在内,广东
梅雁电解铜箔有限公司、梅州市威华铜箔制造有限公司、梅州威利邦电子科技有
限公司等企业也相继涉足铜箔行业。至今,铜箔—电路板产业在梅州市历经了
30 多年发展,并不断推动企业数量增长和产业规模壮大。全梅州市基本上形成
了“铜材—电子电路铜箔—覆铜板—印制电路板—终端产品”、“铜材—锂电铜箔
—锂电池”两个方向的产业链。

2020 年,梅州市铜箔年产能 4.9 万吨,占全国电解铜箔产能的 7.36%,产业
主要集中在梅县区产业集聚地;印制电路板产业规模以上企业有 44 家,1—10
月实现工业总产值 60.47 亿元,产业主要集中在广东梅州经济开发区内。梅州已
经成为广东主要的铜箔—印制电路板生产制造基地。

同时,梅州当地市政府密集出台各项政策,支持建造梅州“中国铜箔之都”:

时间	文件名	发文单位	主要内容
2021 年 12 月	《梅州市战略性 新兴产业发展“十 四五”规划》	梅州市人 民政府办 公室	抢抓铜箔产业成功列入《广东省发展先进材料战略 性支柱产业行动计划(2021—2025 年)》中“河 梅先进材料产业集群”契机,主动融入省 20 大战略 性产业集群行动计划,利用城东白渡园区的沙坪、 梅州坑、上坑工业基地促进企业增资扩产,以梅县 区产业集聚地为主 体,积极打造铜箔新材料特色产 业园,构建“一园多区”的铜箔产业发展新局

时间	文件名	发文单位	主要内容
2021年1月	梅州市铜箔—高端印制电路板产业集群发展规划（2021—2025年）	梅州市人民政府办公室	积极向产业链纵向和横向延伸扩展，推动铜箔—高端印制电路板产业集群做强做大，通过5年乃至更长期的努力，产能规模、技术水平走在全国前列，高端化成效显著，产业生态完善，产业迈上中高端新台阶
2020年11月	梅州市促进铜箔产业发展若干措施	梅州市工业和信息化局	为了着力推动梅州市产业发展，制定了支持铜箔生产企业进行技术改造、支持铜箔生产企业加大科技研发力度等政策
2020年3月	梅州市人民政府办公室关于印发梅州市促进制造业企业增资扩产若干措施的通知	梅州市人民政府办公室	对符合条件的设备更新技术改造项目，在省对新设备购置额予以设备事后奖励的基础上，财政部门进行配套奖励

梅州目前铜箔相关产业集群的形成以及相关产业政策将为发行人未来产能的投产及消化形成有力保证。

2、福建宁德

公司在福建宁德投建的1.5万吨产能项目是公司走出广东省、布局省外锂电铜箔产能所迈出的第一步，该项目的主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端应用领域主要为新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等，下游应用领域较为集中。福建宁德作为国内锂电池和新能源发展的重要坐标，吸引了众多新能源产业链上下游龙头企业的进驻，同时配套了诸多政府出台的投资优惠政策、创新奖补政策等优势条件，是公司考虑在宁德投资建设产能的重要原因。

另外，公司报告期内的前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例均超过80%，其中公司对宁德时代及宁德新能源的销售金额占总营业收入的比例均超过60%。因此公司基于销售结构和客户需求等情况，决定在福建宁德投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目，以更好地服务公司主要客户，同时积极匹配客户的扩建产能，并能以宁德为中心辐射服务周边的锂电池制造厂家。本项目产能的选址与下游需求匹配。

3、山东聊城

发行人在山东的产能布局系通过山东嘉元实施。发行人通过收购山东嘉元的举措，在快速提升产能、开拓北方市场、优化产业布局的同时，利用已经完成的基础建设、已获批的环境容量、能耗指标等先决优势，启动年产 3 万高精度超薄电子铜箔项目二期工程（年产 1.5 万吨），大大缩短了产能建设所需的前期筹备工作，通过加快产能扩张速度，适时填补公司产能不足的缺口。同时，山东产能的投产可以扩大公司销售和服务区域，丰富发行人的客户结构。

4、江西赣州

江西拥有丰富的铜资源，成熟的铜加工产业及上下游集群。赣州市龙南经济技术开发区是电子信息产业发展的重要区域。龙南经济技术开发区着力赣州电子信息产业科技城落户电子信息企业 150 余家，其中 92 家规模以上电子信息企业（含配套企业）实现营业收入 195.3 亿元、同比增长 43.32%，产业集聚度达 63.43%，培育形成 PCB 产业群、PCB 装备制造产业群和电子化学品产业群。龙南电子信息产业集群被认定为全省战略性新兴产业集聚区，是赣州市第二个省级战略性新兴产业集聚区。该地已经建成生益科技、景旺电子、志浩电子、联茂电子、骏亚电子等众多知名的线路板企业，且高速公路、铁路等综合交通网络完善，货运物流成本相对较低，本次项目建成后可充分利用上述资源集聚优势，有效地满足周围地区 PCB 企业的市场需求。

在江西投资建设 2 万吨项目，公司可以充分结合当地铜产业资源，同时配套电子信息产业的对高端标准铜箔铜箔的需求，实现产能高效消化，有利于公司丰富产品结构，进一步拓宽铜箔应用领域和拓展高端电解铜箔市场份额，加强与上下游产业链、供应链的紧密合作，使公司在产业链竞争中占据更有利的地位。

三、发行人 2022 年第一季度业务经营情况，并按照相关规定提交更新数据后的申报文件

根据公司未经审计或审阅的财务报表，2022 年 1-3 月，公司包括营业收入、营业利润、归属于母公司股东的净利润等在内主要经营指标较上年同期均实现增

长。其中，营业收入为 96,268.65 万元，较去年同期增长 81.44%；营业利润为 20,559.69 万元，较去年同期增长 57.72%；归母净利润为 17,402.20 万元，较去年同期增长 57.29%。

公司将按照相关规定提交更新数据后的申报文件。

四、核查程序及核查结论

（一）核查程序

1、查阅公司的历史上在全国中小企业股份转让系统挂牌、科创板首次公开发行并上市的招股说明书等文件，了解公司业务的发展历程；

2、获取公司现有在手订单明细；

3、对公司现有重要 PCB 客户、拟开拓 PCB 客户进行访谈，了解发行人与该客户的合作阶段，未来的合作情况；

4、通过公开网站查询 PCB 市场发展情况、相关政策文件、可比公司扩产情况、下游公司扩产情况等；

5、查阅发行人募投实施地的产业政策及周边产业环境，了解发行人产能选址与下游需求的匹配情况。

（二）核查结论

经核查，保荐机构认为发行人 PCB 铜箔产品面临较广阔的下游市场空间，同时发行人在相关行业具备多年的积累，具备客户资源与技术实力，未来产能消化有保证，融资规模合理。发行人与宁德时代维持了良好的合作关系，发行人产能选址与下游需求匹配，此次融资具备必要性。

（本页无正文，为《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函之回复报告》之盖章页）

广东嘉元科技股份有限公司

2022年5月20日



发行人董事长声明

本人已认真阅读广东嘉元科技股份有限公司本次问询函回复的全部内容，确认回复报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事长：

)

廖平元



(本页无正文，为《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函之回复报告》)之签字盖章页)

保荐代表人：



郭伟健



吴曦

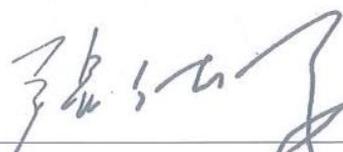


2022年5月20日

保荐机构管理层声明

本人已认真阅读广东嘉元科技股份有限公司本次回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



张佑君



中信证券股份有限公司

2022年5月20日